

Ultra3065

超高熱伝導シート

LiPOLY Ultra3065 は、次世代AIサーバー、高出力GPU、AIアクセラレータ、および高性能演算 (HPC) プラットフォーム向けに設計された、高性能熱伝導ギャップフィラーです。発熱部品とヒートシンクの間の空気層を効果的に充填し、高効率な熱伝導インターフェースを提供します。

Ultra3065 は 30.0 W/m·K の高い熱伝導率を備え、高出力部品の熱をヒートシンクやベーパーチャンバーなどの放熱ソリューションへ効率的に伝導します。優れた圧縮性と貼合性により、部品の高さのばらつきや表面の凹凸にも柔軟に対応し、Shore 000 65 の硬さが、良好な表面密着性と機械的支持性を両立します。Ultra3065 は優れた電気絶縁性能も備えており、絶縁破壊強度は 9 KV/mm に達するため、高密度な電子部品の実装にも適しています。厚さ・サイズはカスタマイズに対応しており、AIサーバー、GPUモジュール、AIアクセラレータ、CPU、HBMパッケージ、電源モジュールをはじめとする各種高出力電子機器に幅広く採用いただけます。

■ 製品ハイライト

- / 超高熱伝導性能
- / 優れた圧縮性と貼合性
- / 信頼性の高い熱伝導性能
- / 優れた電気絶縁性能
- / 高出力演算アプリケーション向け設計

■ アプリケーション分野

- / AI・高性能演算 (HPC)
AIサーバー・GPU・CPU・アクセラレータ・高性能演算 (HPC) プラットフォーム
- / データセンター・ネットワーク通信
データセンター機器・ネットワーク通信機器・通信設備
- / パワーエレクトロニクス
電源モジュール・高出力演算システム

■ 製品仕様特性

THERMAL PERFORMANCE | 熱特性

- / 高熱伝導性能
- / 低熱抵抗
- / 高熱流束アプリケーションに対応

MECHANICAL PROPERTIES | 機械特性

- / 優れた圧縮性と貼合性
- / 部品の間隙差や表面の凹凸を補正
- / 組み立て工程中も安定した接触を維持

ELECTRICAL PERFORMANCE | 電気特性

- / 信頼性の高い電気絶縁性能
- / 高出力アプリケーションのシステム安全性を向上
- / 先進的な演算システムに適合

RELIABILITY PERFORMANCE | 信頼性

- / 長期運用下でも安定した熱性能を維持
- / 温度サイクルおよび湿度環境への耐性
- / ミッションクリティカルなシステムの安定運用をサポート



■ 信頼性

信頼性試験は、記載された試験条件下で実施しています。試験結果は、試験条件やサンプル構成により異なる場合があります。

試験項目	試験条件	試験条件	試験結果
高温	125°C, 1000 hrs.	Pass	Internal Method
高温高湿	85°C / 85% RH, 1000 hrs.	Pass	Internal Method
冷熱衝撃	-40°C ↔ 125°C, 500 cycles	Pass	Internal Method
低温	- 60°C, 1000 hrs.	Pass	Internal Method

■ RECOMMENDED USAGE | 推奨取り付け手順

- / 取り付け前に、接触面が清潔かつ乾燥しており、汚染物がないことを確認してください。
- 実際の間隙サイズおよび部品公差に応じて、適切な厚さの熱伝導ギャップフィラーを選択してください。
- / 取り付け中は、材料を過度に引き伸ばしたり、折り曲げたり、繰り返し動かしたりしないでください。
- / 均一な圧縮を加え、材料と接触面が十分に密着するようにしてください。
- / 過度な圧縮は材料の変形を招くため避けてください。
- / 広い面積への施工では、空気の滞留を抑えるため、段階的に貼り付けることを推奨します。
- / 組み立て完了後、材料と接触面の最終的な密着状態および圧縮の程度を確認してください。

■ 保存方法および基本使用原則

Ultra3065 は、室温環境下で元の包装状態のまま保管し、直射日光および高温環境を避けることを推奨します。取り付け時は実際の用途に応じて適切な製品サイズを選択し、均一な圧縮を確保してください。材料の過度な圧縮、引き伸ばし、または折り曲げは避け、良好な熱伝導性能と材料の完全性を維持してください。